

KM1210HK-J182
EPOXY ADHESIVE PASTE
专业导电无铅银胶



一. 产品描述

KM1210HK-J182 产品是一种单组份低温固化环氧导电银胶。操作时间长 (>24h), 粘接力好, 可靠性稳定, 高剪切强度等特点; 对金属、陶瓷基片、硅芯片、绿油等粘接性好, 可满足回流焊适用场景。

二. 产品应用

该产品广泛应用于 VCM 摄像头模组、PCB 板、FPC、发光二极管 (LED) 集成电路, 晶体管等光电器件的封装和粘接。适用于点胶、蘸胶作业工艺。

三. 产品参数

KM1210HK-J182	项目	测试方法	性能指标
固化前性能	粘度@25℃ (Brookfield DV-II +CP@ 5 rpm)	ASTM D1084-97	4000-5000 cps
	触变指数@ 25℃@ (0.5rpm/5 rpm)	ASTM D1084-97	5.6
	比重		2.91
	含银量	By weight	80%
	使用寿命@ 25℃	-	24Hs
	保质期	-	12Months @ -40℃
	固化条件	-	90min@ 155 °C
固化后性能	体积电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	ASTM-D2397	<0.00028
	硬度	邵氏 D	80
	剪切强度@ 25℃	ASTM-D412	> 1600 psi
	导热系数	ASTM-E1461	5 W/m.k
	玻璃转变温度℃	DSC, 20℃/min	120℃
	热膨胀系数<Tg	TMA	45ppm/° C
	热分解温度, °C	TG, 10K/min	>380℃

四. 注意事项

- 1、拆封：收到冰袋包装的银胶后立刻将银胶转移到-25℃冰柜。
- 2、贮存：低温导电银胶的贮存温度应不高于-25℃。如果在此条件下贮存，该产品达到半年内可使用。贮存期限指明必须有正确的贮存条件，不当的贮存将可能造成点胶的困难和固化后银胶品质降低。
- 3、解冻：本产品在使用之前，先将其回温至室温。在冰箱中取出后，将针筒垂直地放置进行回温。解冻时间，10 克针筒：60min；20 克针筒：90 分钟；50 克瓶装 120 分钟。在解冻时注意擦干外层包装的水分才能取出银胶，取出的银胶需要搅拌均匀后才能正式使用。
- 4、使用：回温后的胶必须立即放在点胶设备上加以使用。如果需要把胶转移到后期点胶器里面，要小心操作，切忌在转移过程中带入杂质或空气。回温后的胶必须在 12 小时内全部使用完。超出工作小时后，放置在室温下的胶会发生银粒子与树脂的分离，可能会造成胶性能不稳定。
- 5、运输：在包装和运输过程中，该产品放在-40℃的干冰中。请及时检查干冰的状态，以确保运输的可靠性。如果检查发现干冰已经融化，请将所有的产品放在-40℃冰箱中，并与 Kmarked 客户服务或销售代表联系。
- 6、包装规格：50cc（50g）、1000cc（1000g）